平成 26 年 5 月 12 日

各　　位

会社名　第一精工株式会社
代表者名　代表取締役社長　小西　英樹
（コード番号 6640　東証第一部）
問合せ先
役職・氏名　経営企画室長　天本　忠勝
電　　話　0942－75－5241

圧電薄膜を用いた MEMS 事業への取り組みに関するお知らせ

当社は、主力のコネクタ、自動車部品、精密機構部品並びに半導体製造装置事業に次ぐ新たな分野への参入を目指し、かねてより検討してまいりました圧電薄膜[*1]を用いたMEMS[*2]の開発及びその技術を応用した新商品開発に向けて取り組む事を決定いたしましたので、下記のとおり概要をお知らせいたします。

[*1] 圧電薄膜（チタン酸ジルコン酸鉛：PZT）
[*2] MEMS：Micro Electro Mechanical Systems（微小電気機械システム）

記

１．開発の概要

（1）新たな開発の内容

圧電薄膜の成膜工程からMEMSデバイスの加工・実装までを行える体制を構築し、新たなMEMSデバイスの開発・商品化を目指します。

（2）平成26年12月期の展開計画

当該製造体制構築のための初期展開として、福岡事業所小郡工場内に約1,500㎡のスペースを準備し、クリーンルームの設置及び成膜装置、関連設備を新設します。

（3）当該開発のために特別に支出する金額及び内容

平成26年12月期において、上記クリーンルームの設置及び成膜装置など関連設備の新設による投資予定額として、総額約10億円を見込んでおります。

（4）当該開発を担当する部門

技術開発本部　新規商品開発部

２．今後の見通し

平成26年12月期は開発投資期間であり、連結業績への影響はございません。

以上